

經濟部國際貿易局 函

地址：臺北市湖口街1號

承辦人：林政偉

聯絡電話：(02)23977261

傳真：(02)23584339

電子郵件：zwlin@trade.gov.tw

受文者：中華民國全國工業總會

發文日期：中華民國111年6月24日

發文字號：貿雙一字第1117020037號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(15852_1117020037-1.tif)

主旨：有關印度電信業生產連結補助計畫(PLI)擴大補助研發產品事，請查照並轉知會員廠商參考。

說明：

- 一、依據駐印度代表處經濟組111年6月22日竺經字第1110005126號函（如附件）辦理。
- 二、前函略以，印度交通部電信局(DoT)頃宣布，為協助發展5G產業生態系，在2018年國家數位通訊政策的架構下，啟動以研發為主的電信製造業政策，將電信業生產連結補助計畫(PLI)納入研發領域，並擴編5.3億美元預算，補助範圍涵蓋多項電信及網路產品，申請期間自111年6月21日至7月20日止，詳細訊息請參考專網 <https://www.pli-telecom.udyamimitra.in>。
- 三、前揭PLI計畫原編列16.25億美元補助，並已在110年10月14日批准31家企業之申請，包括16家中小企業、8家國內大型公司、7家跨國集團。DoT為促進以研發為主的製造業，此次積極邀請具研發能力的製造商參與PLI計畫，中小企業的最低投資門檻為133萬美元，大型企業為1,330萬美元，土地及建築成本均不計入投資。
- 四、本案補助的標準係依據廠商銷售實績的增量達到年度門檻

國際經貿組 111/06/27



1110005294

始能享有補助優惠，以研發為主的製造則額外給予1%補助，並將原匡列補助中小企業預算由1.3億美元提高至3.3億美元。此外，為吸引廠商參與PLI計畫，現有的PLI可展延一年，獲補助廠商可選擇以2021或2022財政年度為補助之基準年。

正本：中華民國全國工業總會、台灣區電機電子工業同業公會

副本：本局局長室、副局長室（以上均含附件）、駐印度代表處經濟組

局長 江文若 電 2022/06/24 文
交 12:12:01 章

裝

訂

線

封套章

國際經貿組 111/06/27



1110005294